

ADVANTEST[®]

WAFER MVM-SEM[®]

E3310

次世代ウエハ対応の多次元観察・測長SEM



E3310は、1Xnmノードのプロセス開発および22nm世代以降の量産デバイス向けに開発されたウエハ用MVM-SEM*です。デュアルアーム真空ロボットを採用した高速搬送システムと、測定精度を向上させるための低振動プラットフォームの採用により、高精度、高スループットのウエハ測定性能を実現しました。さらに、マルチディテクタ構成と独創的な3D計測アルゴリズムの採用により、FinFETプロセスなどの3D構造を安定かつ高精度に測定します。E3310は様々なアプリケーションを組み合わせることにより、次世代デバイスなどのプロセス開発TAT短縮と生産性向上に貢献します。

*: Multi Vision Metrology Scanning Electron Microscope(多次元観察・測長走査型電子顕微鏡)

測定対象

- シリコン・ウエハ
- アルチック・ウエハ
- クォーツ・ウエハ
- シリコンカーバイド・ウエハ

* Wafer Sizeは150mm~300mm搬送可(要相談)

先進の電子光学カラム設計

独自のカラム・デザインとユニークな電子ビーム走査技術は、フォトマスク用として多数の導入実績のあるE3630を踏襲しています。高い測定分解能を実現するために、カラム内部を高電圧に保つアドバンテスト独自のアーキテクチャと新規に開発した対物レンズにより、色収差を大幅に低減し、低加速領域での分解能が一層向上しました。

高安定・全自動画像取得

新型の高精度位置決めステージ・システム、チャージアップ抑制技術、コンタミネーション低減技術により、高倍率のSEM画像取得においても安定して測定対象が画像センタに位置決めされ、高スループットでの全自動測定を実現します。

次世代プロセス開発への対応技術

複数の2次電子検出器で構成されたマルチディテクタ・システムを搭載し、1Xnm ノードプロセスにおいても、安定かつ高精度な測定を実現しています。また、ユニークな解析アルゴリズムと組み合わせた3D計測機能により、FinFET等立体構造の新しいプロセスコントロール情報を提供することでプロセス開発のTAT短縮に寄与します。

豊富なアプリケーション

- 広視野SEM画像による自動多点測定機能
- SEM画像からのパターン輪郭抽出・GDS出力機能
- マルチディテクタ・システムから生成する3D表示機能
- SECS/GEM対応

MVM-SEMIは、(株)アドバンテストの日本、米国およびその他の国における登録商標または商標です。



- 本製品を正しくご利用いただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
- 本カタログ記載の製品仕様及び外観等は、予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

ADVANTEST®

<http://www.advantest.co.jp>

株式会社アドバンテスト

- 本製品に関するお問合せは
ナノテクノロジー事業部
〒349-1158 埼玉県加須市新利根1-5 埼玉R&Dセンタ
TEL : 0480-72-6300
E-mail : info_nano@ml.advantest.com